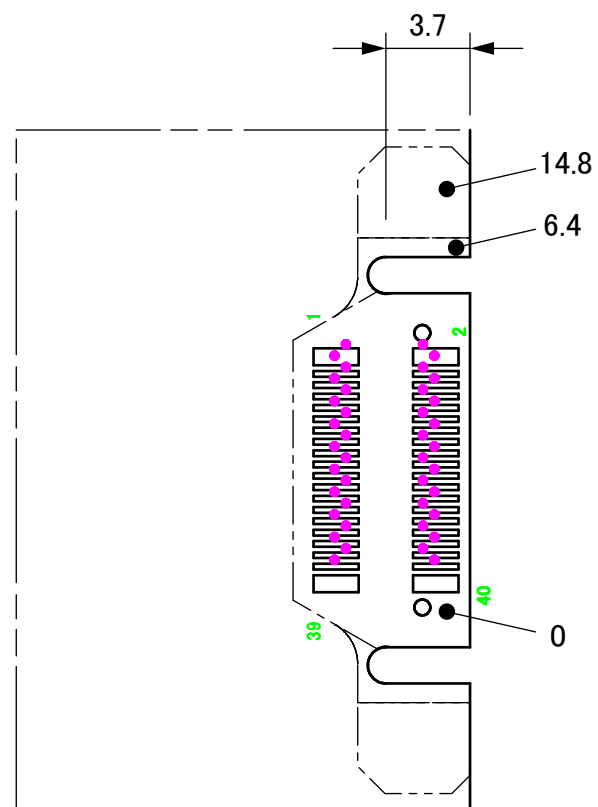


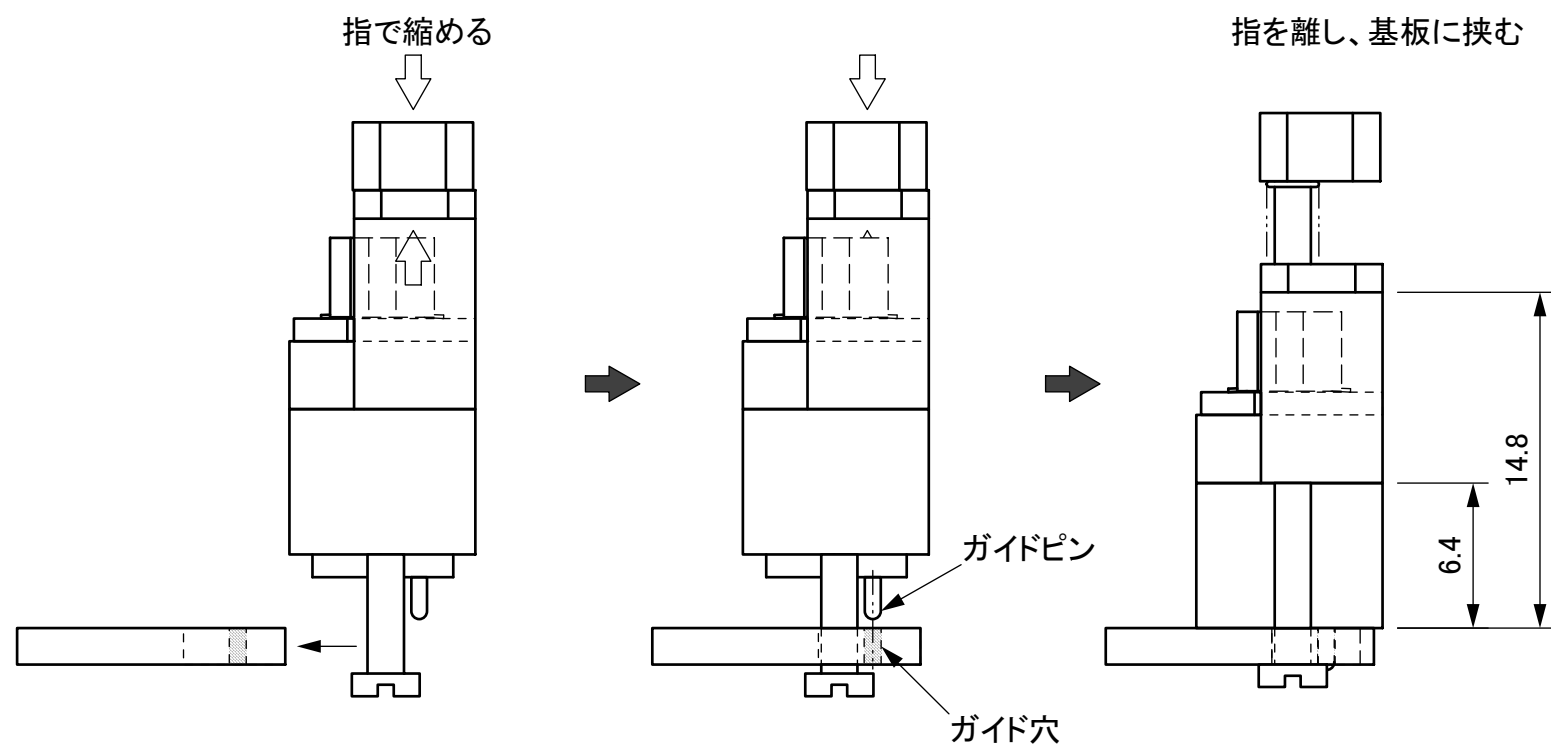
基板端への搭載時



基板とのZ方向のクリアランス

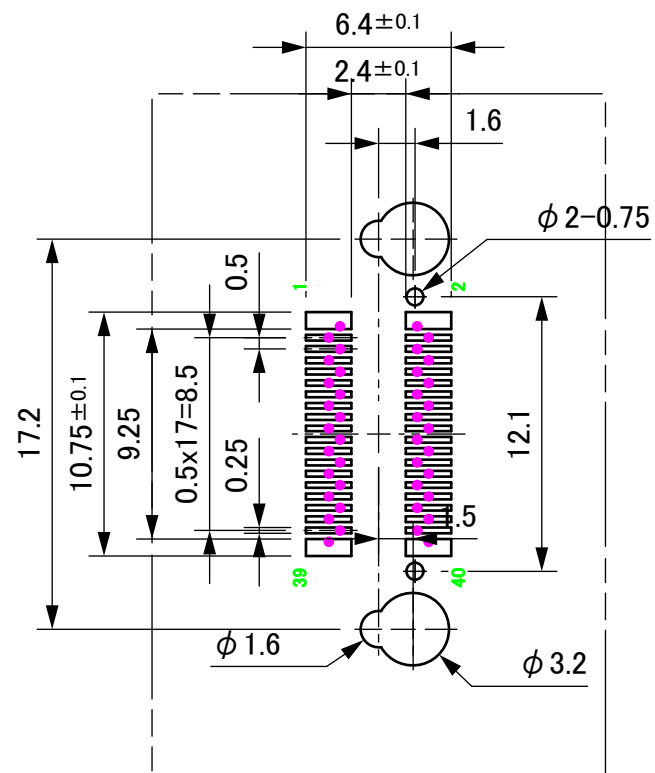
NOTE)

- 1.基板厚 : t=1.6
- 2.表面処理: 金フラッシュメッキ(推奨)、または半田レベラー (フラックスは不可)
3. ⊙ はポゴピンの接触ポイントを表す。
- 4.指定外公差: ±0.05

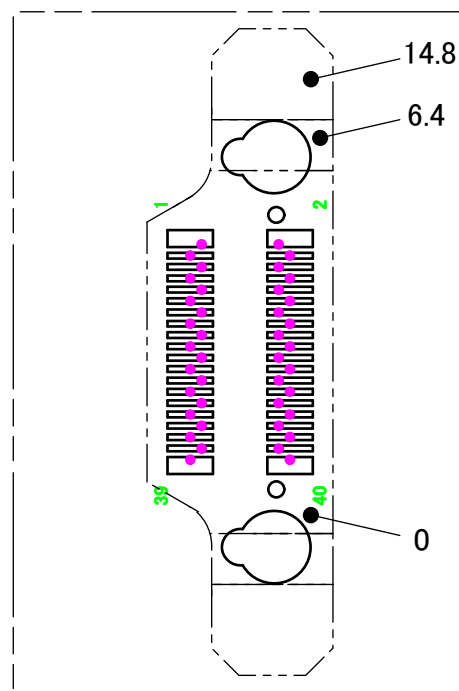


支柱部を基板端の切り欠きに入れ、ガイドピンをガイド穴に合わせる

Part No.	SICA40D40Y-GAP1 フットパターン図 (板端への搭載)
Unit	mm
Design / Date	M.Miura / Jun.01.'09
TET TOKYO ELETECH CORP.	



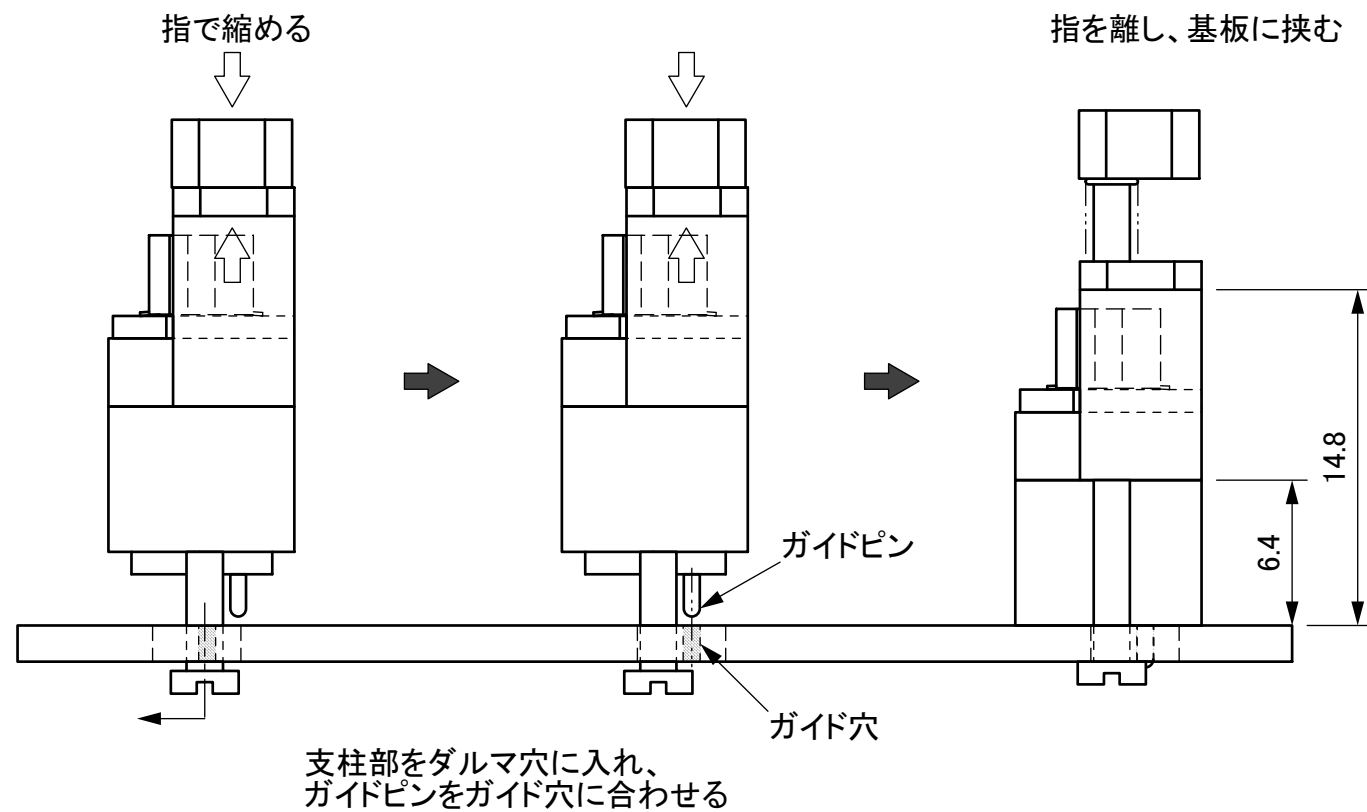
基板端以外への搭載時



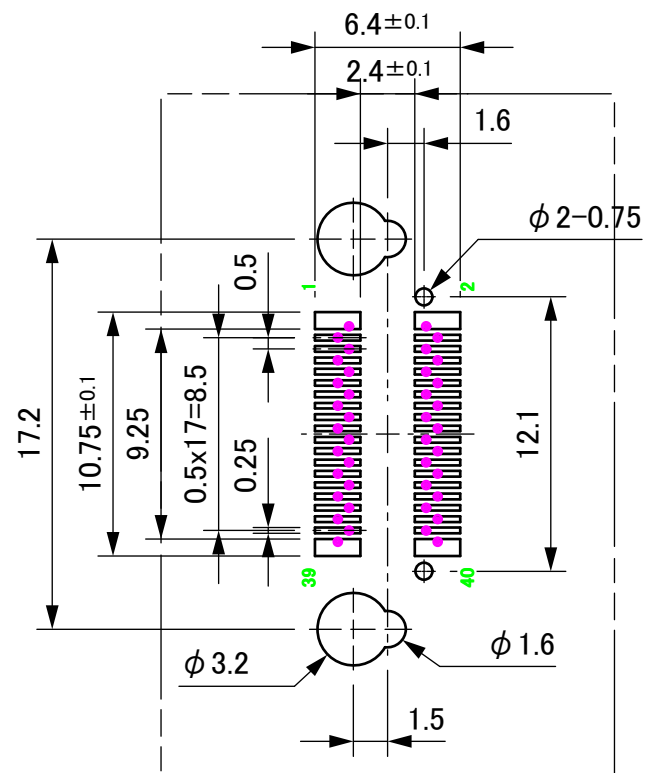
基板とのZ方向のクリアランス

NOTE)

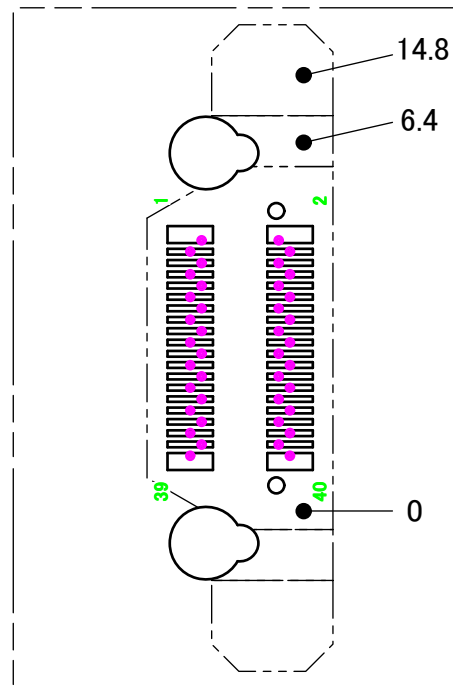
- 1.基板厚 : t=1.6
- 2.表面処理 : 金フラッシュメッキ (推奨)、または半田レベラー (フラックスは不可)
3. ◎ はポゴピンの接触ポイントを表す。
- 4.指定外公差 : ±0.05



Part No.	SICA40D40Y-GAP1 フットパターン図 (板端以外への搭載)
Unit	mm
Design / Date	M.Miura / Jun.01.'09
TET TOKYO ELETECH CORP.	



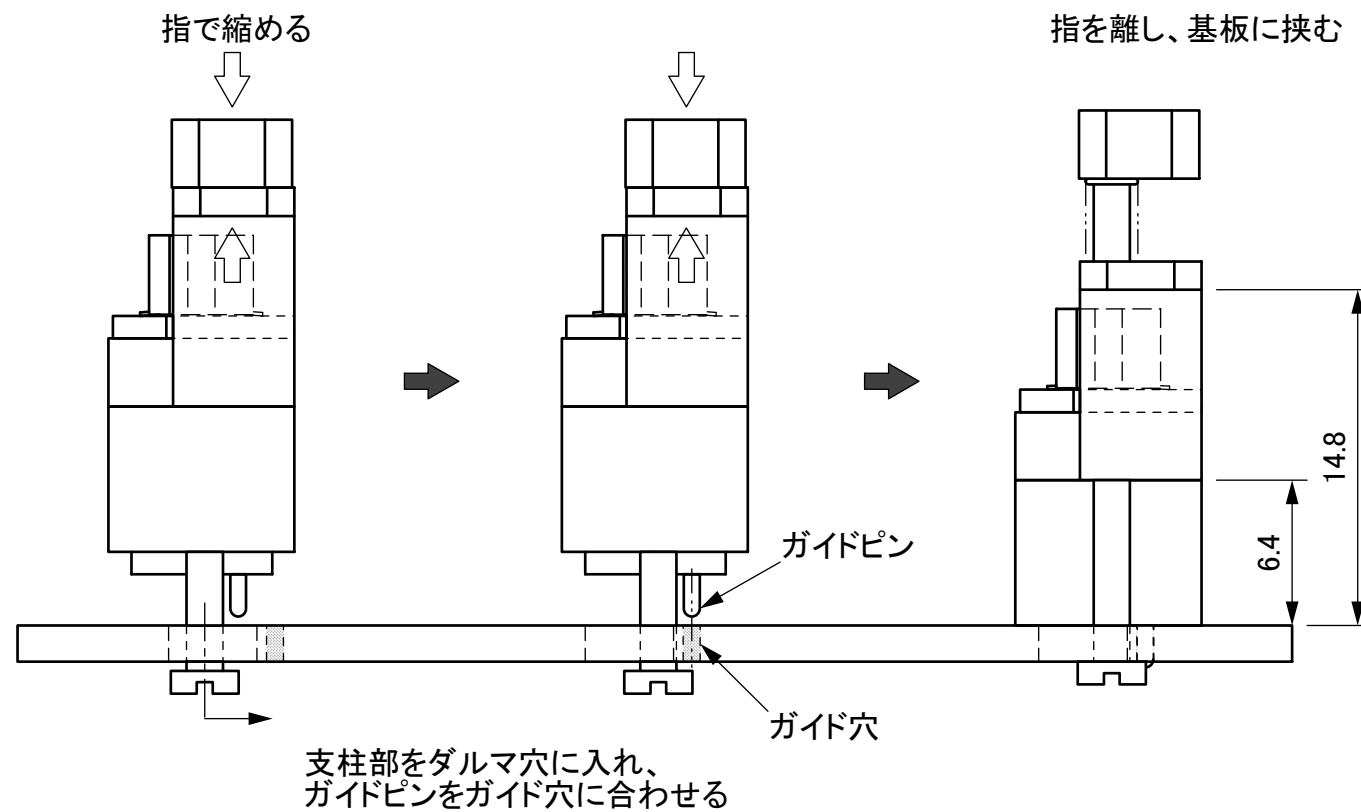
基板端以外への搭載時



基板とのZ方向のクリアランス

NOTE)

- 1.基板厚 : t=1.6
- 2.表面処理 : 金フラッシュメッキ (推奨)、または半田レベラー (フラックスは不可)
3. ⊙ はポゴピンの接触位置を表す。
- 4.指定外公差 : ±0.05



Part No.	SICA40D40Y-GAP1 フットパターン図 (板端以外への搭載)
Unit	mm
Design / Date	M.Miura / Jun.01.'09
TET TOKYO ELETECH CORP.	